

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表
(2024年5月14日-15日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（） |
| 参与单位名称 | 国盛证券、太平洋证券、国泰基金、兴全基金、汇丰晋信基金、中欧基金、长江养老、华泰柏瑞、申万菱信基金 |
| 活动时间 | 2024年5月14日、5月15日 |
| 活动地点 | 策略会、线上交流 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、公司的成本端如何拆分？答：公司产品的成本主要包括晶圆采购、封测服务等，其中晶圆采购成本占比更高。不同的产品的具体成本构成亦有所不同。2、公司对于现有领域的拓展及未来市场的拓展是如何规划的？答：公司聚焦存储芯片设计领域，经过多年的经验积累和技术升级，公司打造了以低功耗、高可靠性为特点的多品类存储芯片产品，产品下游主要应用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗等领域。公司将通过持续的研发创新、制程升级和性能迭代，保持公司现有产品的技术先进性。公司将在现有应用领域的基础上，加大对物联网、智能硬件应用、汽车电子、医疗健康等新兴领域的布局和开拓，提高公司产品的市场占有率，同步提升定制化产品及服务的能力。公司也将以存储产品为核心，拓展智能化外延并以应用为导向，开发具有特色的存储产品，通过差异化提升盈利空间；持续开拓国内优质客户，服务行业重要客户，逐步拓展海外市场，提升公司在全球的市场地位和影响力。3、公司的DDR3主要给哪些客户？答：公司研发的DDR3(L)系列是可以传输</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>双倍数据流的 DRAM 产品，具有高带宽、低延时等特点，在通讯设备、移动终端等领域应用广泛，具体客户比如 OTT BOX、IPC 等客户。4、MCP 产品的增量主要来自哪些方面？答：MCP 的主要应用以模块类的产品为主，我们看到有部分客户的应用需求从 3G、4G 模块逐步转向 5G 模块，带来了产品容量的升级。未来我们会继续进行 MCP 产品型号和组合的升级，并导入更多的市场应用。5、请问公司目前晶圆代工的成本是什么情况？答：公司结合市场情况与晶圆厂保持及时有效沟通，2023 年公司晶圆整体采购成本呈下降趋势，对于产品成本的改善会逐步显现出来。</p> |
| 日期 | 2024 年 5 月 16 日 |